



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年10月28日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役 専務執行役員 (氏名) 堀 哲朗

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成28年11月11日

配当支払開始予定日

平成28年11月28日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	352,722	3.5	60,012	△2.0	62,365	△0.0	41,966	1.4
28年3月期第2四半期	340,951	15.9	61,250	103.4	62,384	96.3	41,376	106.7

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 32,710百万円 (△7.0%) 28年3月期第2四半期 35,153百万円 (50.7%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第2四半期	255.83	255.16
28年3月期第2四半期	238.10	237.46

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第2四半期	840,047	579,712	68.7
28年3月期	793,367	564,239	70.9

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 576,791百万円 28年3月期 562,369百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	125.00	—	112.00	237.00
29年3月期	—	128.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	177.00	305.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	762,000	14.8	140,000	19.9	142,000	18.9	100,000	28.4	609.57

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年3月期2Q	165,210,911 株	28年3月期	165,210,911 株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	1,154,615 株	28年3月期	1,176,800 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期2Q	164,043,016 株	28年3月期2Q	173,781,675 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成28年10月28日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(四半期連結損益計算書関係)	12
(セグメント情報等)	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、全体としては緩やかな回復基調が続いているものの、中国の景気減速や英国のEU離脱選択等の影響による先行きの不透明感は払拭されていません。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、デジタルデータ通信量の増加基調に伴う好調なサーバー需要や、モバイル機器におけるデータ処理の高機能化と大容量化を背景に、半導体・電子部品の需要は堅調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,527億2千2百万円(前年同期比3.5%増)、営業利益600億1千2百万円(前年同期比2.0%減)、経常利益623億6千5百万円(前年同期比0.0%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は419億6千6百万円(前年同期比1.4%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

上述のエレクトロニクス産業の市況を受け、ロジック系半導体メーカーによる先端技術への投資や、3次元構造のNANDフラッシュメモリ向けの投資が好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3,270億8百万円(前年同期比3.2%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

モバイル端末用の中小型液晶パネル向けの設備投資が伸長したほか、大型液晶パネル向けの設備投資も続いており、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、254億7千9百万円(前年同期比39.4%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億3千4百万円(前年同期比95.9%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
売上高	340,951	322,997
半導体製造装置	316,987	296,044
日本	62,820	53,451
米国	60,267	43,193
欧州	26,674	24,414
韓国	53,351	46,223
台湾	76,058	85,871
中国	31,125	32,480
東南アジア他	6,689	10,410
F P D製造装置	18,275	26,411
その他	5,687	541
営業利益	61,250	55,538
経常利益	62,384	57,014
親会社株主に帰属する 四半期純利益	41,376	36,514

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
352,722	147,976	204,745
327,008	130,796	196,211
44,248	17,819	26,429
51,439	17,022	34,416
11,930	5,234	6,695
48,837	19,805	29,031
88,794	30,504	58,289
54,093	30,049	24,044
27,664	10,360	17,304
25,479	17,064	8,414
234	115	119
60,012	22,095	37,916
62,365	24,083	38,281
41,966	12,684	29,281

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	298,007	294,223
F P D製造装置	23,194	27,750
その他	5,124	-
合計	326,325	321,973

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
343,732	140,236	203,496
16,455	9,623	6,832
-	-	-
360,188	149,860	210,328

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	276,291	346,643
F P D製造装置	24,349	26,153
その他	2,039	501
合計	302,680	373,299

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
393,192	197,496	195,695
30,988	15,955	15,032
231	111	119
424,412	213,564	210,848

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位：百万円)

	前期第2Q末	前期期末	当期第1Q末	当期第2Q末
半導体製造装置	212,689	263,288	329,988	329,473
F P D製造装置	37,686	37,428	36,319	42,937
その他	44	4	1	0
合 計	250,419	300,721	366,309	372,411

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ527億9千4百万円増加し、6,702億1千万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の増加327億7千9百万円、現金及び預金の増加212億8千3百万円、たな卸資産の増加98億4千9百万円、未収消費税等の減少115億2千9百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から1億2千5百万円減少し、961億9千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から26億1百万円減少し、150億1百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から33億8千7百万円減少し、586億4千4百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から466億7千9百万円増加し、8,400億4千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ316億5千2百万円増加し、1,977億1千3百万円となりました。主として、前受金の増加281億4千2百万円、賞与引当金の増加55億6千6百万円、支払手形及び買掛金の増加39億5千8百万円、未払法人税等の減少42億6千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ4億4千6百万円減少し、626億2千1百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ154億7千3百万円増加し、5,797億1千2百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益419億6千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当183億7千1百万円の実施による減少、その他の包括利益累計額92億6千5百万円の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は68.7%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ137億8千6百万円増加し、1,094億2千5百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,462億3千2百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ189億8千3百万円増加し、2,556億5千7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ44億3千1百万円増加の520億7百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益544億2千万円、前受金の増加294億1千万円、未収消費税等の減少114億7千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加370億2千3百万円、法人税等の支払額207億2千9百万円、たな卸資産の増加153億5千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出96億3千1百万円、短期投資の増加による支出52億1百万円により、前年同期の1,118億1千4百万円の支出に対し150億6千8百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払183億7千1百万円により、前年同期の1,010億円の支出に対し183億7千7百万円の支出となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の連結業績につきましては、主力の半導体製造装置事業の足元の受注状況に鑑み、引き続き市況は好調に推移することが見込まれることから、平成28年5月12日に公表した通期の連結業績予想を以下のとおり上方修正いたします。

平成29年3月期の連結業績予想

	通 期
売上高	7,620億円 (前年同期比 14.8%増)
半導体製造装置	7,125億円 (前年同期比 16.2%増)
F P D 製造装置	490億円 (前年同期比 9.7%増)
その他	5億円 (前年同期比 92.0%減)
営業利益	1,400億円 (前年同期比 19.9%増)
経常利益	1,420億円 (前年同期比 18.9%増)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,000億円 (前年同期比 28.4%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日)を第 1 四半期連結会計期間に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	75,674	96,957
受取手形及び売掛金	116,503	149,283
有価証券	160,999	158,700
商品及び製品	130,478	133,131
仕掛品	41,556	46,806
原材料及び貯蔵品	23,044	24,991
その他	69,207	60,395
貸倒引当金	△48	△54
流動資産合計	617,416	670,210
固定資産		
有形固定資産	96,316	96,191
無形固定資産		
その他	17,603	15,001
無形固定資産合計	17,603	15,001
投資その他の資産		
その他	63,857	60,420
貸倒引当金	△1,825	△1,776
投資その他の資産合計	62,031	58,644
固定資産合計	175,951	169,836
資産合計	793,367	840,047
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	55,050	59,008
未払法人税等	22,460	18,199
賞与引当金	11,623	17,190
その他の引当金	10,108	8,607
その他	66,818	94,707
流動負債合計	166,060	197,713
固定負債		
その他の引当金	374	374
退職給付に係る負債	55,302	56,301
その他	7,390	5,944
固定負債合計	63,067	62,621
負債合計	229,128	260,334

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	427,618	451,153
自己株式	△8,050	△7,899
株主資本合計	552,551	576,238
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,902	5,889
繰延ヘッジ損益	50	6
為替換算調整勘定	6,742	△686
退職給付に係る調整累計額	△4,877	△4,656
その他の包括利益累計額合計	9,817	552
新株予約権	1,641	2,683
非支配株主持分	228	237
純資産合計	564,239	579,712
負債純資産合計	793,367	840,047

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
売上高	340,951	352,722
売上原価	204,940	214,032
売上総利益	136,010	138,689
販売費及び一般管理費		
研究開発費	37,578	39,805
その他	37,181	38,871
販売費及び一般管理費合計	74,759	78,677
営業利益	61,250	60,012
営業外収益		
為替差益	32	946
その他	1,693	1,537
営業外収益合計	1,725	2,483
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	91	55
自己株式取得費用	360	—
その他	139	75
営業外費用合計	591	131
経常利益	62,384	62,365
特別利益		
固定資産売却益	998	43
その他	—	6
特別利益合計	998	50
特別損失		
減損損失	4,434	—
災害による損失	—	7,828
その他	1,429	166
特別損失合計	5,864	7,994
税金等調整前四半期純利益	57,519	54,420
法人税等	16,123	12,426
四半期純利益	41,396	41,993
非支配株主に帰属する四半期純利益	19	27
親会社株主に帰属する四半期純利益	41,376	41,966

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
四半期純利益	41,396	41,993
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,376	△2,012
繰延ヘッジ損益	△148	△25
為替換算調整勘定	△1,913	△7,375
退職給付に係る調整額	△801	209
持分法適用会社に対する持分相当額	△2	△79
その他の包括利益合計	△6,242	△9,283
四半期包括利益	35,153	32,710
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	35,146	32,701
非支配株主に係る四半期包括利益	7	8

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	57,519	54,420
減価償却費	9,376	8,199
減損損失	4,434	—
のれん償却額	628	307
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,318	5,900
関係会社株式売却損益 (△は益)	1,110	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△420	△37,023
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,195	△15,353
仕入債務の増減額 (△は減少)	△11,168	6,634
未収消費税等の増減額 (△は増加)	13,480	11,475
前受金の増減額 (△は減少)	△4,798	29,410
その他	△8,302	8,106
小計	54,346	72,077
利息及び配当金の受取額	608	659
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△7,378	△20,729
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,576	52,007
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	12	—
短期投資の増減額 (△は増加)	△108,492	△5,201
有形固定資産の取得による支出	△4,713	△9,631
無形固定資産の取得による支出	△305	△320
その他	1,684	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△111,814	△15,068
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△88,756	△4
配当金の支払額	△12,190	△18,371
その他	△53	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△101,000	△18,377
現金及び現金同等物に係る換算差額	△189	△4,775
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△165,427	13,786
現金及び現金同等物の期首残高	317,632	95,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,204	109,425

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

災害による損失

平成 28 年熊本地震の影響による、建物、生産・開発設備等の原状回復及び在庫の廃棄等に係る実績及び現時点での見積費用であります。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第 2 四半期連結累計期間(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	327,008	25,479	6,954	359,442	△6,719	352,722
セグメント利益	71,637	1,733	31	73,403	△18,983	54,420

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、PV(太陽光パネル)製造装置事業及び当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△18,983 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△7,983 百万円及び、災害による損失△7,828 百万円等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。